

产业链图谱



半导体行业

——行业概要/产业链全景图谱（上游行业、中游行业、下游行业）

更新时间：2024年4月



【洞见趋势 研判未来】扫码关注公众号，解锁百篇免费报告

洞见研报全面覆盖各行商业投资领域行业研究报告、行业报告，350万+报告，960万+数据图标，依托海量宏观策略、行业发展规划、上市公司、蓝白皮书等研究报告，致力于为投资者、咨询顾问、商业分析师提供便捷全面，实时及专业的信息共享服务。

行业概要

简介

半导体是电子行业不可或缺的关键元件，它们在特定的环境条件下能够导电，而在其他条件下则不具备导电性。这种特性使得半导体可以在温度升高至某个特定值时，从绝缘体转变为导体。因此，半导体能够对电流的流动进行有效控制，这使得它们在多种电子设备中发挥着不可替代的作用。

发展

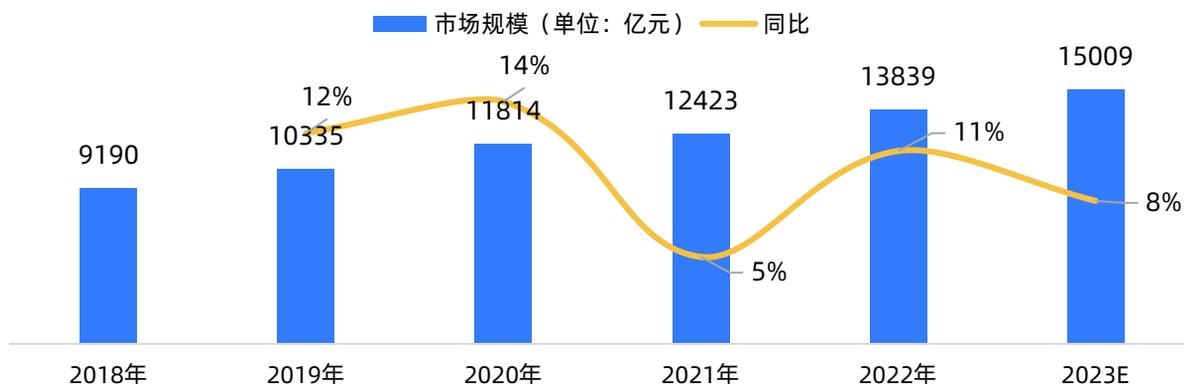
半导体行业的技术发展经历了多个阶段。自20世纪60年代中期起，仙童半导体公司引领了集成电路的大规模生产技术。随后，半导体行业逐步过渡到集成器件制造（IDM）的垂直整合模式，该模式整合了从设计、生产到封装测试的整个流程。

随着个人电脑和移动互联网等下游应用的扩展，集成电路（IC）行业开始转向垂直分工的模式，成为主要的发展趋势。在这种模式下，没有生产线的IC设计公司开始与采用标准工艺的加工线合作，形成了集成电路产业发展的新趋势。

市场规模

随着全球电子制造业向发展中国家和地区的转移，中国的半导体行业也实现了快速增长。从2017年的7885亿元销售额增长到2022年的13839亿元，预计到2023年，中国半导体行业的市场规模将进一步增长到15009亿元。

2018年-2023E中国半导体行业市场规模及同比



资料来源：中国半导体行业协会，国投证券，公开资料整理，[洞见研报分析整理](#)

产业链全景图谱

上游：半导体材料

硅片	高纯化学试剂	特种气体	光刻胶	靶材
      	      	       	      	     

中游：半导体制造

制造设备	芯片设计	封测
       	       	        

下游：应用领域

网络通信	计算机	消费电子	工业控制	汽车电子
     	       	       	       	   <p>.....</p>

上游行业1：硅片

• 简介

硅片在半导体材料中占据着至关重要的地位，其价值占比高达37%，是核心材料中的关键。硅片的制造要求和工艺技术标准极高。硅片的发展趋势是向更大尺寸的演进，其中12英寸硅片已成为主流。

• 重点企业

 **GlobalWafers Co., Ltd.** 環球晶團股份有限公司 前身是中美硅晶制品股份有限公司的半导体事业部。中美硅晶集团成立于1981年，位于新竹科学工业园区，拥有太阳能电池和组件生产线，并涉足下游发电系统业务，是国内垂直整合最完整的公司之一。中美硅晶积极调整产品销售策略，拓展硅材料应用产品，以扩大产品应用范围。

ShinEtsu 集团自主开发的聚氯乙烯、有机硅和纤维素衍生物等原料已在全球多地建立产销网络。为保证产品品质，集团自行生产主要原料金属硅，实现从原料到成品的一贯制生产。广泛应用于电子、汽车、机械、化工、纺织、食品及建筑等多个行业，为各产业提供高价值产品。

TCL 中环 是一家领先的光伏硅片制造商，其前身为1958年成立的天津市半导体材料厂，拥有深厚的硅片技术经验积累。TCL中环在光伏硅片制造领域占据全球龙头地位，特别是作为210（G12）大尺寸硅片的引领者，其硅片对外销售规模保持领先。

• 其他参与企业

隆基绿能	沪硅产业	安彩高科	神工股份
双良节能	欧晶科技	天合光能	美畅股份
弘元绿能	晶盛机电	晶科能源	京运通
高测股份	奥特维	通威股份	中晶科技
立昂微	晶澳科技	大全能源	金博股份

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，公开资料整理，[洞见研报分析整理](#)

上游行业2：高纯化学试剂

• 简介

高纯化学试剂的品质对电子产品的制造成功率、电气特性和长期稳定性具有决定性影响。在制造手机、计算机、新能源电池等设备时，必须使用包括光刻胶及其配套试剂、封装材料、高纯度化学品、工艺用化学品和液晶屏材料等。这些材料在不同的生产阶段中发挥着关键作用，包括清洗、显影、漂洗、蚀刻和剥离等过程所需的专用液体。

• 重点企业



天科股份公司目前的核心业务包括氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品以及技术服务等五大领域，为先进材料、特种化学品和创新服务的综合供应商。



东阳光业务范围涵盖电子新材料、合金材料、化工产品等。在高纯化学试剂相关产业方面，东阳光专注于电子材料产业链的深耕，包括化成箔、电池箔、电容器等产品的生产和销售。



新宙邦是全球知名的电子化学品和功能材料生产商。公司以创新的电子化学品和功能材料为社会带来积极变化，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品和半导体化学品等，广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市交通、生物医药、5G通信、光伏储能和工业制造等多个行业。

• 其他参与企业

晶瑞电子材料	艾森股份	恒光股份	中触媒
光华科技	三孚股份	胜华新材	金禾实业
兴欣新材料	华融化学	镇洋发展	丛麟科技
格林达	新化股份	华尔泰	星球石墨
西陇科学	和远气体	三友化工	嘉化能源

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，公开资料整理，洞见研报分析整理

上游行业3：特种气体

简介

特种气体分为多个类别，包括掺杂气、外延气、离子注入用气、LED用气、光刻气以及载运和稀释气体等。光刻气作为光刻机产生深紫外激光的关键，其不同类型产生的光源波长各异，对光刻机分辨率有直接影响，是光刻技术的核心要素之一。在半导体产业中，使用的特种气体超过110种，其中20至30种为常用气体，它们在原材料需求中占有高达13%的比例，仅排在大硅片之后。

重点企业



普莱克斯公司成立于1907年，是首家实现氧气深冷分离技术商业化的企业。该公司专注于生产、销售和分销各类气体产品，包括大气气体、工艺气体、特种气体，以及提供高性能涂料和相关服务与技术。普莱克斯服务的客户群体广泛，涵盖航空航天、化工、食品饮料、电子、能源、医疗、制造业以及金属等多个行业。



Peric是国内及世界领先的电子特气企业，专注于电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。公司经过多年的技术创新和发展，已经具备了50余种电子特种气体及含氟新材料的生产能力，实现了企业大宗制气的技术突破。



金宏气体成立于1999年，是专业从事气体研发、生产、销售和服務的安全、环保、集约型综合气体提供商。公司主要为客户提供各种大宗气体、特种气体和天然气的一站式供气解决方案。

其他参与企业

侨源股份	硅烷科技	雅克科技	永和股份
九丰能源	和远气体	中巨芯	建业股份
杭氧股份	中船重工	水发燃气	濮阳惠成
正帆科技	南大光电	晨光新材	雪迪龙
昊华科技	广钢气体	创元科技	卫星化学

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，公开资料整理，洞见研报分析整理

上游行业4：光刻胶

简介

光刻胶是光刻机制造过程中的关键材料，它的作用是让光刻机能将集成电路图案精准“投射”到硅片上。为避免硅片表面留下不必要的“印记”，需在其上均匀涂抹光刻胶。光刻胶不仅用于芯片制造，还广泛应用于高端面板、模拟半导体、LED、光电子和光子器件等领域。

重点企业

 JSR株式会社 是全球领先的光刻胶生产企业之一，其光刻胶产业具有深厚的技术积累和广泛的市场影响力。JSR正在积极布局EUV光刻胶领域，以应对半导体行业对更先进制程技术的需求。

 是全球最大的光刻胶制造商之一，尤其在高端光刻胶市场中占有重要份额。信越化学在全球拥有广泛的生产和销售网络，包括日本、美国、荷兰、中国台湾、韩国、新加坡以及中国浙江和上海等地。

 雅克科技的光刻胶业务涵盖了多种产品，包括面板用正性TFT光刻胶、RGB彩色光刻胶、CNT防静电材料以及光刻胶配套试剂等。为包括三星电子、LG Display、京东方、华星光电、惠科等知名面板供应商批量供应产品。

其他参与企业

华特气体	百川股份	富祥药业	双乐股份
瑞联新材	大族激光	腾景科技	安达智能
鼎龙股份	彤程新材	上海新阳	赛微电子
圣泉集团	华特气体	芯源微	炬光科技
万润股份	芯碁微装	晶方科技	湖北宜化

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，公开资料整理，[洞见研报分析整理](#)

上游行业5：靶材

• 简介

靶材是半导体薄膜沉积的关键材料，是一种用于溅射沉积的高纯度材料。根据半导体材料的种类，靶材可分为多种类型，包括硅（Si）、氮化硅（Si₃N₄）、氧化物（如二氧化硅、三氧化二铝等）、化合物半导体（如砷化镓GaAs、氮化铝AlN等）以及其他材料。这些靶材都是经过严格的制备工艺，以保证其高纯度、均匀性和稳定性。

• 重点企业

 **JX金属** 公司专注于金属和化合物材料的制造与供应，产品线涵盖拉伸铜材、特种钢材、铜箔、化合物半导体以及高纯金属等多元化产品。

Honeywell 是全球领先的多元化技术和制造企业，其在靶材相关产业中占据重要地位。霍尼韦尔的靶材业务主要涉及高纯溅射靶材的生产，这类材料在半导体制造、显示面板、光伏等领域制备功能薄膜过程中发挥着核心作用。

 **JDC** 是亚洲、世界领先的钼专业供应商，为国际钼协会执行理事单位、中国有色金属工业协会钼业分会会长单位，被中国矿业联合会授予“中国钼业之都”称号。拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化产业链条，主要生产钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列二十多种品质优良的各类钼产品。

• 其他参与企业

新疆众和（上市）	光智科技（上市）	爱发科成膜技术（合肥）有限公司（非上市）	广东江丰电子材料有限公司（非上市）
有研新材（上市）	江丰电子（上市）	东莞市欧莱溅射靶材有限公司（非上市）	广东欧莱高新材料股份有限公司（非上市）
阿石创（上市）	康达新材（上市）	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（非上市）	广州市尤特新材料有限公司（非上市）
安泰科技（上市）	隆华科技（上市）	丰联科光电（洛阳）股份有限公司（非上市）	贵州贵能移动新能源有限公司（非上市）
超卓航科（上市）	美特林科（上市）	光洋新材料科技（昆山）有限公司（非上市）	合肥江丰电子材料有限公司（非上市）

*报告上市企业选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，公开资料整理，[洞见研报分析整理](#)

中游行业1：制造设备

简介

芯片制造过程中的设备包括：光刻机、刻蚀机、PVD、CVD、离子注入、炉管设备、检测设备、清洗设备、切割设备。

重点企业

 **ASML** 成立于1984年，总部设在荷兰埃因霍温的全球最大的半导体设备制造商之一。阿斯麦（ASML）为半导体生产商提供光刻机及相关服务，TWINSKAN系列是世界上精度最高，生产效率最高，应用最为广泛的高端光刻机型。全球绝大多数半导体生产厂商，都向阿斯麦采购TWINSKAN机型。

 **NAURA 北方华创** 成立于2001年，是目前国内集成电路高端工艺装备的先进企业。北方华创以科技创新为基点，着眼未来，致力于加快推进北方华创向新型制造业的战略转型；致力于成为半导体基础产品领域值得信赖的引领者；致力于提升人类智能生活品质；致力于实现中国“智造强国”的梦想蓝图。北方华创主营半导体装备、真空及锂电装备、精密元器件业务，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。

 **AMEC中微** 成立于2001年，是一家以中国为基地、面向全球的微观加工高端设备公司，为集成电路和泛半导体行业提供极具竞争力的高端设备和高质量的服务。中微开发的等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备是制造各种微观器件的关键设备，可加工微米级和纳米级的各种器件。

其他参与企业

威海广泰	盾安环境	盛剑环境	新海退
璞泰来	杭氧股份	中船防务	宏华数科
奥特维	新莱应材	弘元绿能	大有能源
中粮科工	宁德时代	达刚控股	陕鼓动力
贵州三力	伟明环保	杭萧钢构	凯利泰

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，[洞见研报分析整理](#)

中游行业2：芯片设计

简介

芯片设计需要进行电路分析和模拟、芯片架构设计、电路细节设计、芯片布局和布线设计、芯片验证和测试等多个步骤。只有经过严格的设计流程和测试验证，才能保证芯片的正确性和稳定性，从而为电子产品的正常工作提供坚实的保障。

重点企业

QUALCOMM 成立于1985年，是全球智能手机 SoC 与射频前端龙头，连续多年蝉联全球第一大芯片设计公司。高通通过提供全球首款集成调制解调器、射频收发器和射频前端的商用芯片组解决方案，支持OEM厂商快速开发先进的5G终端。



成立于1993年，早期专注于图形芯片设计业务，随着公司技术与业务发展，已成长为一家提供全栈计算的人工智能公司，致力于开发CPU、DPU、GPU和AI软件，为建筑工程、金融服务、科学研究、制造业、汽车等领域的计算解决方案提供支持。

AMD 成立于1969年，是一家美国半导体跨国公司。公司致力于开发设计集成电路产品，主要产品包括中央处理器、图形处理器、主板芯片组等，为游戏、人工智能、云计算等领域提供计算解决方案。

其他参与企业

鼎龙股份	万盛股份	雅创电子	软通动力
汇顶科技	北京君正	苏州固锴	奥比中光
韦尔股份	纳思达	电科网安	德明利
新洁能	恒玄科技	万通发展	复旦微电
紫光国微	南芯科技	富瀚微	国芯科技

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，[洞见研报分析整理](#)

中游行业3：封测

简介

封测主要包含切割/减薄、贴装/互联、封装、测试等过程，分别对应切割减薄设备、引线机、键合机、分选测试机等，是将半导体材料模块集中于一个保护壳内，防止物理损坏或化学腐蚀，最后将通过测试的产品投入到应用中去。

重点企业

 **ASE GROUP**
日月光集團 成立于1984年，总部位于台湾，是一家专注于半导体及相关设备的领先企业。该公司凭借强大的技术实力和丰富的行业经验，在全球半导体封装和测试服务领域占据重要地位，为客户提供全方位的电子制造服务集成解决方案。

 **Amkor Technology** 于1968年在韩国成立的第一家半导体企业，公司总部位于美国亚利桑那州坦佩市，是外包半导体封装和测试行业的全球领导者。安靠不仅提供针对于逻辑芯片、数控芯片、存储芯片及射频芯片等移动设备应用领域主流芯片的完整测试方案，还涵盖了晶圆测试、老化测试、电性能测试以及系统级测试等各种晶圆级和芯片级测试能力。

 **长电科技**
CHANGJIANG ELEC.TECH. 成立于1972年，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。长电科技封装业务涵盖了引线框架封装、复合基板封装、倒装芯片互连和先进晶圆级技术等全套封装服务，以满足客户对半导体封装的各种需求。

其他参与企业

伟测科技	捷捷微电	艾为电子	气派科技
和林微纳	长川科技	韦尔股份	芯源微
华海诚科	华天科技	飞凯材料	联瑞新材
华峰测控	新洁能	环旭电子	金海通
京东方A	兴森科技	新益昌	芯联集成

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，[洞见研报分析整理](#)

下游行业1：网络通信

简介

网络通信是指通过有线或无线方式，实现信息传输、交换、处理和应用服务的产业领域。这个行业可以根据传输媒介的不同，分为有线通信和无线通信两大类。有线通信包括固定电话、宽带接入等，而无线通信则涵盖移动通信、卫星通信等。

重点企业

ZTE中兴 成立于1985年，是全球领先的综合通信解决方案提供商，中国最大的通信设备上市公司。主要产品包括：2G/3G/4G/5G无线基站与核心网、IMS、固网接入与承载、光网络、芯片、高端路由器、智能交换机、政企网、大数据、云计算、数据中心、手机及家庭终端等。

FI 富士康工业互联网 成立于2015年，是全球领先的智能制造及工业互联网整体解决方案服务商，迄今已在中国美国、新加坡、捷克、匈牙利、墨西哥、越南、印度、日本等多个国家及地区开展经营业务，拥有全球3C电子行业最完整、最高效的供应链和最大规模、快速量产的智能制造能力，主要业务包含通信及移动网络设备、云计算、工业互联网。

W 沪士电子 WUS Printed Circuit 成立于1992年，自成立以来一直立足于印制电路板的研发设计和生产制造。公司主导产品广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备、数据中心、网通、微波射频、半导体芯片测试等多个领域。

其他参与企业

亿联网络	捷捷微电	艾为电子	气派科技
和林微纳	长川科技	韦尔股份	芯源微
华海诚科	华天科技	飞凯材料	联瑞新材
华峰测控	新洁能	环旭电子	金海通
京东方A	兴森科技	新益昌	芯联集成

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，[洞见研报分析整理](#)

下游行业2：计算机

简介

计算机涉及计算机硬件、软件、网络以及相关服务的产业和领域。近年来，随着技术的进步，计算机行业也在不断发展。人工智能、云计算、区块链技术、5G技术、物联网等新兴技术为计算机行业带来了新的发展机遇。这些技术的应用不仅提高了计算机的性能和智能化水平，还推动了各个行业的数字化转型和创新发展。

重点企业

 **Microsoft** 是一家美国跨国科技企业，1975年4月4日创立，以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。最为著名和畅销的产品为Windows操作系统和Office系列软件，是全球最大的电脑软件提供商。

 **海康威视** 成立于2001年，是一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务。公司力图构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务，并致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。

 **科大讯飞** 成立于1999年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业，公司总部在合肥。自成立以来，一直从事智能语音、自然语言理解、计算机视觉等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平；积极推动人工智能产品和行业应用落地，致力让机器“能听会说，能理解会思考”，用人工智能建设美好世界。

其他参与企业

同为股份	中科曙光	宇瞳光学	品茗科技
诺力股份	并行科技	宝信软件	京北方
莱斯信息	中科软	中科信息	萤石网络
网宿科技	科大讯飞	启明星辰	中科星图
朗鸿科技	新大陆	华大九天	广电运通

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，[洞见研报分析整理](#)

下游行业3：消费电子

简介

消费电子涵盖了制造和销售消费性电子产品的广泛领域，其范围包括智能手机、家用电器、数码产品等众多品类。这个行业以满足消费者在生活与工作沟通、资讯、事务处理和娱乐等需求为核心，不断推出新产品和更新技术，以适应市场需求和科技进步。

重点企业



是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务。



是一家总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的知名科技公司，以其创新的iPhone、iPad、Mac电脑、可穿戴设备等产品闻名于世，同时提供丰富的软件和服务，持续引领全球科技潮流，是全球市值最高的公司之一。



是一家起源于1938年的韩国跨国企业巨头，业务涵盖电子、金融、机械、化学等多个领域，其旗下子公司如三星电子、三星SDI等在各自领域均占据重要地位。特别是在消费电子领域，三星凭借其创新的技术和卓越的产品质量，已成为全球领先的消费电子企业之一。

其他参与企业

传音控股	环旭电子	电连技术	雅葆轩
安克创新	视源股份	拓邦股份	统联精密
飞荣达	歌尔股份	蓝思科技	ST美讯
工业富联	立讯精密	达瑞电子	兴瑞科技
莱尔科技	领益智造	福蓉科技	漫步者

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，[洞见研报分析整理](#)

下游行业4：工业控制

简介

工业控制是指通过自动化和控制技术来实现对工业生产过程的控制和管理。它在工业生产中起着至关重要的作用，能够提高生产效率、降低成本、提高产品质量等。

重点企业

SIEMENS 成立于1847年，是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。西门子提供一系列先进的工业控制产品，包括PLC、变频器、触摸屏等，这些产品广泛应用于冶金、化工、印刷生产线等领域，为工业生产提供精准可靠的控制。同时，西门子紧跟工业4.0趋势，运用云计算、工业物联网等新技术推动工业自动化系统的升级。其数字孪生仿真平台等创新解决方案，进一步优化了生产过程，提升了生产效率。

ABB 成立于1988年，是瑞士著名的大型跨国企业，总部位于瑞士苏黎世，是瑞士十大跨国企业之一。阿西布朗勃法瑞公司是世界上最大的生产工业、能源、自动化产品的公司之一。

SUNGRWOW 阳光电源 是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。

其他参与企业

纳芯微	普冉股份	拓邦股份	科翔股份
安路科技	上海贝岭	维峰电子	英威腾
斯达半导	睿能科技	中富电路	易事特
芯海科技	聚辰股份	复旦微电	航宇微
本川智能	四会富仕	伟创电气	骏亚科技

*报告选取行业相关度TOP20，统计时间为2024年4月16日。

资料来源：企查查，同花顺问财，公司官网，[洞见研报分析整理](#)

专业免费的行业研究数据库，3500000+报告，覆盖各行业研究报告、行业报告、咨询报告、上市公司研报、招股书、蓝白皮书等，采用智能搜索引擎、自然语言处理等技术，并根据市场需求创建了web端和微信小程序端两种模式为金融投资人员、企业高管、咨询顾问、行业研究员、市场分析师提供便捷、全面、专业的信息检索服务！

智能收藏



标星等级



WORD/PPT下载



随手笔记



专项订阅



随时随地



专业深入洞察，适配企业需求

精准把握消费者心理，定制产品定位策略
细致剖析行业竞争格局，塑造差异化优势
全面扫描行业市场脉络，捕捉趋势与机遇
策略性审视企业全局，引领调整发展方向

· 消费者调研

· 竞对调研

· 市场调研

· 战略咨询

研究支持

专业品宣

· 行业趋势白皮书

· 用户洞察白皮书

· 市场地位论证

· 专业技术论证

挖掘行业信息，助力品牌推广

联合企业发布行业白皮书，研究行业前景
剖析行业发展现状与动态，探索潜力赛道
提供市场地位及专业论证，夯实品牌地位
立足公司特色业务产品，凸显品牌专业度

本报告为洞见研报制作，其版权归属洞见研报，任何机构和个人引用或转载本报告时需注明来源为洞见研报，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何未注明出处的引用、转载和其他相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。对任何有悖原意的曲解、恶意解读、删节和修改等行为所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任，并保留追究相关责任的权力。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。本公司将来可能根据不同假设、研究方法、即时动态信息和市场表现，发表与本报告不一致的意见、观点及预测，本公司没有义务向本报告所有接受者进行更新。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载观点、结论和建议仅供参考使用，不作为投资建议，对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。



APP (安卓&IOS)



微信小程序



微信公众号

——扫描二维码解锁百篇免费报告——